

2016.4.1～2017.3.31

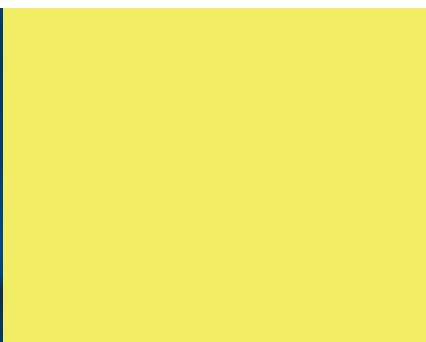
特集

## 新中長期経営計画 事業本部長・所長インタビュー

証券コード 5384

技術を磨き、心をつなぐ

# FUJIMI



お客様目線の実践  
「働きがい」と「働きやすさ」の醸成  
パウダー&サーフェスカンパニーへの進化  
革新への挑戦



# 技術を磨き、心をつなぐ

私たちの「磨く技術」は半導体をはじめとした  
さまざまな産業で活かされています。  
フジミはお客様にあらゆる製品を  
磨いていただくことで、  
人々が快適に暮らせる未来の創造に  
貢献します。

代表取締役社長

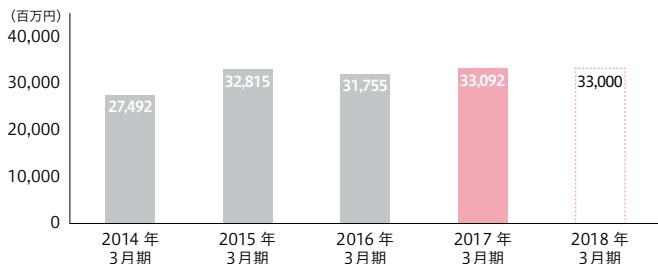
関 敬史



## 連結決算ハイライト

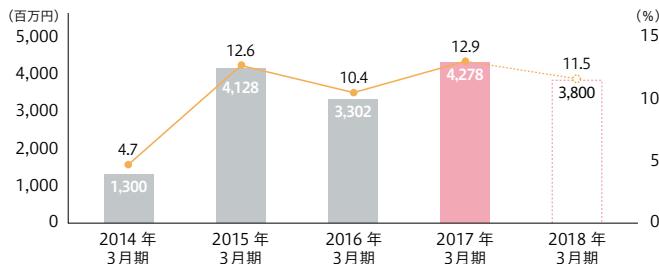
■ 通期    ● 通期    ※2018年3月期は予想値

### ■ 売上高



### ■ 営業利益・営業利益率

折れ線グラフ: 営業利益率 (右軸)



# 株主の皆様へ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

## 2017年3月期の経営成績

当社グループを取り巻く環境は、米国経済は景気回復の動きがみられ、日本・欧州経済は力強さを欠くものの景気の底堅さがみられましたが、中国では景気減速が継続しました。また、英国のEU離脱問題や米国新政権の動向の影響もあり、世界経済の先行きは不透明な状況が続きました。一方、世界半導体市場は、ロジックデバイス、メモリデバイスともに堅調な需要に支えられ、夏場以降、前年の実績を上回る形で推移し、成長基調となりました。

こうした状況下、当社グループでは一丸となって売上拡大とコスト削減に努めました結果、当連結会計年度の業績は、売上高33,092百万円(前期比4.2%増)、営業利益4,278百万円(前期比29.5%増)、経常利益4,519百万円(前期比35.2%増)、親会社株主に帰属する当期純利益3,350百万円(前期比42.8%増)となりました。

## 2017年度経営方針

年度経営方針は、2016年11月に発表しました新中長期経

営計画を踏まえ、4つの方針を掲げました。

(1)お客様目線の実践：従来から掲げている経営方針ですが、お客様の立場で考え行動することの重要性を垂訓するもので、着実に社内への浸透が進んでおります。

(2)「働きがい」と「働きやすさ」の醸成：新中長期経営計画の重要なポイントであり、今年度新たに経営方針に加えております。従業員が働きがいを持って、安心して仕事に取り組める環境づくりを推進してまいります。

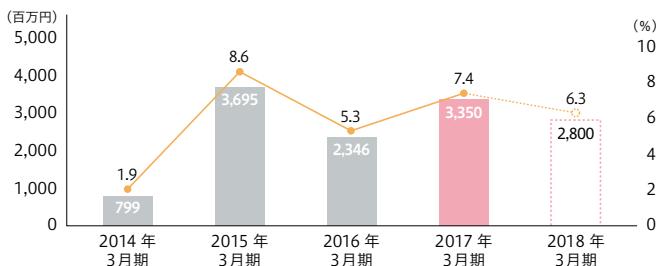
(3)パウダー&サーフェスカンパニーへの進化：新中長期経営計画の策定を踏まえ従来の研磨材中心の事業領域をパウダー(粉)とサーフェス(表面)に広げ、業態を「進化」させたいとの思いを込めて、新たに経営方針に加えしました。

(4)革新への挑戦：こちらも従来から掲げている経営方針ですが、当社は精密研磨材のトップメーカーとして長年業界をリードしてきました。そのような歴史と現状に満足することなく、常に変革と成長を続ける企業でありたいと考えております。

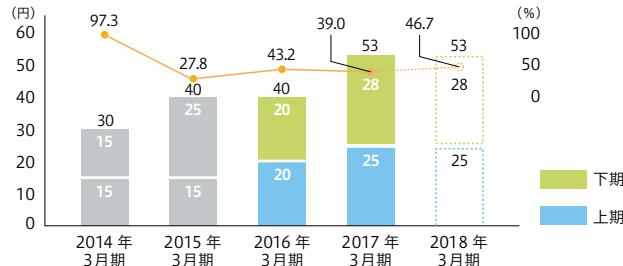
新中長期経営計画を達成すべく、これら4つの方針の下、全社一丸となって取り組んでまいります。

皆様のご厚情に感謝するとともに、これまでと変わらぬご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

■親会社株主に帰属する当期純利益・ROE 折れ線グラフ: ROE(右軸)



■配当金・連結配当性向 折れ線グラフ: 連結配当性向(右軸)





## 特集 新中長期経営計画 事業本部長・所長インタビュー

### 新中長期経営計画の概要

当社は2022年3月期を最終年度とする新たな6カ年計画(新中長期経営計画)を策定し、2016年11月に発表しました。新中長期経営計画の狙いは3つあります。1つ目は、事業領域の拡大です。当社は研磨材メーカーとしての意識を持って活動してまいりましたが、企業ビジョンとしては、「パウダー&サーフェス分野」を掲げております。研磨以外の分野である粉(パウダー)や表面(サーフェス)分野に於いて事業領域を拡大していきたいと考えております。2つ目は、プロセス重視の考え方です。売上や利益目標に至る道筋や、目標に対して何を行ったかも重要であるという考え方です。3つ目は、従業員のモチベーション向上です。企業文化ビジョンとして「強く、やさしく、面白い会社を目指します」とあります。従業員が仕事の面白

みをもっと感じられるように「私たちは一人ひとりの前向きなアイデアとチャレンジを応援します」を中長期企業ビジョンとして掲げることとしました。

当社のサクセスストーリーは、あるメーカーから「トランジスタに用いるゲルマニウム\*基板を磨けますか?」と声をかけられたことに端を発します。原点に立ち返る意味でも、このエピソードをもう一度思い出し、お客様から最初に声をかけてもらえるような圧倒的な技術力を持ち、さらにその技術力を世の中に対して理解していただく活動が必要であると考えております。世の中の期待にかなう製品を作ることができているか?と常に問い続けながら、技術を磨き、事業展開を進めてまいります。今回の特集では、4事業本部、1研究所の2017年3月期の振り返りと、新中長期経営計画に基づいた事業計画を、各事業本部長、所長からお伝えします。

#### \*ゲルマニウム

原子番号32の元素。元素記号はGe。ケイ素(シリコン)が登場するまではトランジスタ(増幅やスイッチ動作の半導体素子)の主流材料。

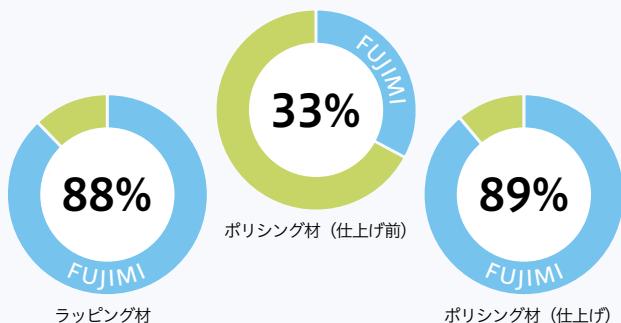
## シリコン事業本部

シリコン事業本部長

森 嘉男

当社の基幹事業の一つを担うシリコン事業本部は、シリコンウェハーを磨く研磨材において8～9割の世界シェアを有する製品を保有しております。パソコンをはじめとする多種多様な電子・IT関連機器に使用されている半導体、その基板として用いられるのがシリコンウェハーです。当社は、そのシリコンウェハー向け研磨材のトップメーカーとして、技術を高め、利益を生み出し、次なる高みへと挑戦を続けております。

### シリコンウェハー向け研磨材市場シェア



### スマートフォン市場の堅実な成長に加え、データセンター用半導体などの伸びにより好調な一年

2017年3月期は、シリコン事業本部として好調な一年となりました。300mmシリコンウェハーの出荷枚数が、一年を通じて活況の目安となる月間500万枚を超えたと報告されております。例年の傾向として、春夏は好調で、秋冬は出荷枚数が減少するのですが、昨年度は春夏の勢いのまま年度末を迎えました。要因は、スマートフォン

の中国市場の伸びやデータセンター用途での半導体需要量が増加したこと、自動車の制御やパワー半導体が伸びていることなどであると言われております。

### 従業員モチベーション向上をベースに、ナンバーワンの座を維持する

シリコンウェハー向け研磨材のトップメーカーとして、ウェハー加工に関する情報は非常に豊富にあり、切断から仕上げ研磨までフルラインナップで対応することができております。

当社の基幹事業として、新技術のたゆまぬ追求は必須命題であり、既存製品のマイナーチェンジをすることで満足せず、他社の模倣を許さない技術を追求しております。そのためには、科学に裏付けられた大きなモデルチェンジを意識していくことが必要で、このことは従業員のモチベーション向上にも欠かせません。また、合理化やコストダウンの視点も極めて重要です。自社内での合理化はもちろんのこと、お客様のコストダウンにも寄与する視点を忘れてはなりません。

新たな取り組みとしては、研磨の周辺工程への可能性探索や、次世代パワー半導体に対応する研磨加工の可能性を探ってまいります。



## CMP事業本部

取締役CMP事業本部長 兼 FUJIMI CORPORATION社長  
兼 FUJIMI TAIWAN LIMITED 董事長 鈴木 勝弘

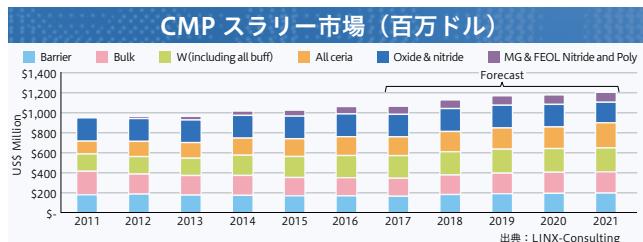
CMP事業本部は、半導体デバイスの製造工程で用いられる研磨材を製造販売しております。CMP（化学機械研磨）用製品群は、シリコンウェハー用のファイナルポリッシング材のノウハウを応用して開発され、トランジスタ素子形成工程や多層配線に対応したラインナップを揃えております。

常にお客様のロードマップに沿った迅速な新規開発品の提供と技術サービスを核に、市場シェアの拡大を目指しております。また、米国、台湾、韓国のお客様を中心に、ハイテク&ハイエンドをコンセプトに事業展開をしております。

### アジアを舞台に、 トレンドの変化とともに事業展開

2017年3月期はDRAM\*やNAND\*型フラッシュメモリをはじめとするメモリ市場と先端ロジック市場が活況で、それに牽引されて当社のCMPスラリーの売上は増大しました。NAND型フラッシュメモリでは微細化の困難さが顕在化し、2次元構造から3次元構造へとデバイス製造が変化するという非常に大きなトレンドの変化があった一年でした。

半導体メモリの大手のお客様が中国で立ち上げた3次元



\*DRAM (Dynamic Random Access Memory)  
コンピュータなどに使用される半導体メモリの一種。

\*NAND (Not AND)  
不揮発性記憶素子のフラッシュメモリの一種。



NAND型フラッシュメモリの事業が軌道に乗り、好況を呈しております。また別のお客様が昨年、中国の半導体製造工場をメモリ工場に転換しました。こちらでも当社のスラリーが使用されており、メモリ向けのビジネスが当社の売上に大きく貢献しました。

### 世界企業から技術力を評価され、 次なる市場に挑戦

米国インテル社から、当社の技術力が高く評価され、この2017年3月にSCQI\*という賞をいただきました。この賞を獲得できたのは、当社が日本、米国、台湾のそれぞれで営業、開発、製造を行い、いち早く新規開発品を提供するなどのお客様へのサポート体制が充実しているからであり、このことがお客様からの高い評価に繋がっていると考えております。

今後、中国政府が半導体関連の国内調達率を2020年までに現在の5%から40%に引き上げるため、5兆円規模の投資をされると言われております。当社が強みを持つトランジスタ素子形成用途で使用されるスラリーを活かして、中国の上海事務所、台湾のフジミ台湾と連携を強化し、この大きな半導体市場の獲得に取り組んでまいります。

\*SCQI (Supplier Continuous Quality Improvement award)  
インテル社の目標に対して卓越した成績を達成し、品質、コスト、供給体制、技術力、顧客サービス、労務・倫理システム、環境持続性などの重点項目に対して優れた成績を取ったサプライヤーに贈られる最も名誉ある賞。

# 機能材事業本部

取締役機能材事業本部長 兼

FUJIMI-MICRO TECHNOLOGY SDN. BHD.社長 大脇 寿樹

機能材事業本部は、3つの事業があり、事業ごとにお話します。

## (1) ディスク事業

パソコンの記憶装置やDVDレコーダーなどに搭載されているハードディスク用アルミ基板・ガラス基板向け研磨材を取り扱っております。パソコンの需要減少やSSD\*の普及などにより市場が縮小傾向である中、2017年3月期も一定の売上を確保できたのは、お客様に密着した研究開発活動や営業活動によりお客様の信頼を勝ち得たためと考えております。2018年3月期も顧客密着型ソリューション提案を基本方針として、引き続き多方面からお客様のニーズにお応えしてまいります。

## (2) 機能材事業

LT/LN\*、プラスチックレンズ、ガラス、光学レンズなどの用途に係る研磨材やプラスト\*材、機能性材料などを取り扱っております。2017年3月期はグローバル展開とともに機械

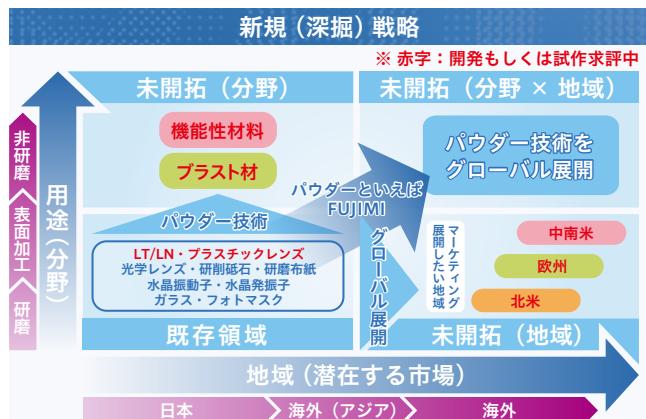


メーカーとの協働が進み、新たな市場探索につながる活動ができました。2018年3月期もそれらの活動を継続してまいります。また、粉（パウダー）を知る事業として、機能性材料の展開を考えております。例えば車のブレーキや各種充填材の分野など、当社にとって新たな分野の市場調査を行い、営業活動と新規開発を推進しております。

## (3) 溶射材事業

金属などの物質表面をコーティングする材料を取り扱っております。同事業はパウダーを作る当社の技術を活かした比較的新しい事業です。2017年3月期は過去最高の売上を達成するだけでなく、目標である航空機産業に対し、新たな展開の足がかりを作ることができました。溶射材の用途は一般工業機械から航空機に至るまで多岐にわたっており、特に特殊な環境下（高温や腐食環境など）で使用される部材の表面保護用途に対応できると考えております。

最後に、機能材事業本部は従業員のモチベーション向上に関して、営業職には高度な技術が語れる力の、開発職には開発の基礎知識力の向上に向け、個人の能力引き上げを進めております。



### \*SSD

Solid State Driveの略。  
HDD(Hard Disk Drive)の代わりに、  
半導体メモリを利用した記憶装置。

### \*LT/LN

LT：タンタル酸リチウム / LN：ニオブ酸リチウム  
スマートフォンなどに搭載される通信用電子部品  
SAWフィルタに使用される。

### \*プラスト

表面処理を行う方法の一種。  
圧縮した空気を利用して研磨材などのメディアを  
加工対象に噴出して表面処理を行う。

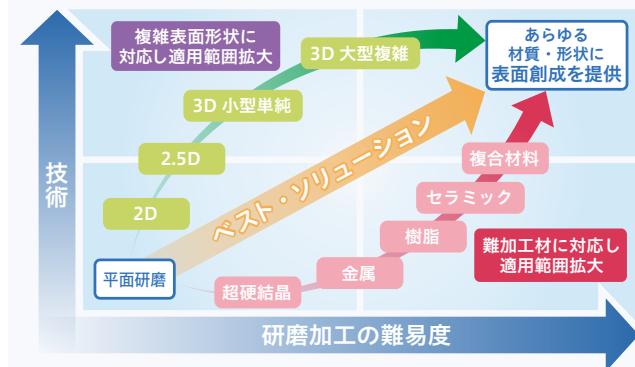
## 新規事業本部

新規事業本部長 兼 深圳福吉米科技有限公司董事長

森永 均

新規事業本部では、シリコン、CMP、ハードディスクなど既存事業以外の新規用途で用いられる、金属、セラミック、樹脂などの多種多様な一般工業用品向け研磨材などを製造販売しております。様々な業界のお客様から寄せられる新たな表面加工ニーズに、研磨装置や周辺消耗材の提案・提供を含めたトータルソリューションでお応えしております。

### 事業領域拡大に向けた技術ロードマップ



### 技術軸と市場軸の両面から新規事業を創出

当本部は、LED\* などの環境・エネルギー分野や、スマートフォンやタブレットなどのモバイル・ディスプレイ分野、工業デザイン・外装分野などに対応しております。これら様々な分野への取り組みは、新たな技術の確立や、今までにない商材創出のきっかけにもなります。一例を挙げますと、LED 用途への取り組みでは、サファイ



こうぜい

ア基板に代表される硬脆材料\*を研磨できる商材が求められ、スマートフォンや工業デザイン分野に展開すれば、合金や3D研磨技術\*が必要になります。このように、様々な市場の表面加工ニーズに向き合うことで、既存の半導体用途では必要なかった、様々な難加工面に適した、新たな研磨技術・新商材を徐々に増やすことができました。現在は、あらゆる材質、形状に対応する研磨技術の開発を進めつつ、新たに展開する市場の探索活動を同時に進めております。

### 表面創成ニーズに応え、感動を届けたい

「新しい表面を作りたい」という、表面創成ニーズに対し、競合他社の追随を許さないソリューションで応えることにより、お客様に感動を届け、新たな世界を切り拓くことが、新規事業本部の基本戦略です。そのために、研磨部品の見本を持って海外メーカーへプレゼンテーションに行ったり、展示会に参加して多くの企業と出会うなど、異業種・異分野の企業との交流を積極的に行うようにしております。ものづくりで先端を走る企業のパートナーとして、新しい表面の創成に取り組んでまいります。

\*LED (Light Emitting Diode)  
電圧を加えた時に発光する半導体素子のこと。  
発光ダイオードとも呼ばれる。

\*硬脆材料  
非常に硬いが、衝撃などに弱い材料。

\*3D研磨技術  
平面ではなく、立体の凹凸ある表面を磨くための技術。

# 先端技術研究所

先端技術研究所 所長

## 扇谷 聡

先端技術研究所の目的と役割は、以下の3つです。

- (1) 基幹技術開発（基盤技術を強化し深耕、新規技術の開発）
- (2) 開発企画（新規事業機会の創出と育成）
- (3) 事業企画（M&A\*、ベンチャー企業投資の実行と推進）

事業部間で共通する要素技術の開発および事業機会の調整を行っており、状況に応じて事業部と協働し取り組んでおります。当研究所は、5年以上先を見据えた活動となるため、展示会や学会、大学、公的な研究機関などを網羅し、新しい技術やビジネス機会を模索・事業化するためにさまざまな活動をしております。

### ベンチャー企業へ出資の実施と積極的な事業開発

2015年末にベンチャー投資組合を設立し、有望なベンチャー企業に出資しております。2017年3月期は3社への投資を実行しました。これまでの出資先の選定は、



当社が得意とする分離技術や研磨技術とともに進めているベンチャー企業などです。また既存技術の強化や新規の技術開発にも取り組んでまいりました。産学官連携にも挑戦し、外部の大学の研究室とともに大きなプロジェクトを推進しております。

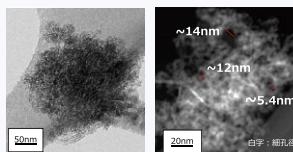
### 無機素材と高耐熱材料で、未来の社会に貢献できる技術を

素材は大きく分けると、有機材料\*と無機材料\*があり、当社が強みを持っているのは無機材料です。当社の保有技術と得意技術、強化したい素材技術で、競争優位性を高めていきたいと考えております。

低炭素社会に貢献する材料分野を特に注目しております。具体的には、エネルギー分野（二次電池、燃料電池、水素など）、省エネルギー分野（高耐熱材料や低負荷分離、遮熱材料など）、低CO<sub>2</sub>排出材料分野です。なかでも今年度から注力しているのが、高耐熱材料の分野です。動力機関にいま以上に、高い耐熱性を持った材料が使用されるようになれば、一段と高温で運転することができ、エネルギー効率が向上しCO<sub>2</sub>の排出量削減に貢献できます。これは未来の社会に必ず必要となる技術です。当社の発展に貢献し、同時に社会にも貢献する、それが先端技術研究所の夢です。

#### (例)新規粒子

##### メソポーラスアルミナについて



- ・数nm～十数nmの微細な細孔を持つ
- ・細孔径・細孔容積の微調整可能

##### 期待される用途（一例）



排ガスなどの有害物質吸着

各種物質を担持

放熱フィルター

アルミナ微粒子の非研磨用途への期待

\*M&A (Merger and Acquisition)

Merger(合併)とAcquisition(買収)の略。  
2つ以上の会社が1つになったり、ある会社が他の会社を買収すること。

\*有機材料

炭素を含む物質の総称。  
プラスチック、ゴム、紙などの材料。

\*無機材料

有機材料でもなく、金属でもない物質。  
セラミックスなどの材料。

# 用途別の動き

## シリコンウェハー用

売上構成比

28.5%

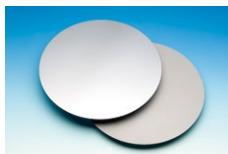
シリコンウェハー向け製品につきましては、ラッピング材の売上高は3,193百万円(前期比0.7%増)、ポリシング材の売上高は一部製品の販売増加により、6,245百万円(前期比8.6%増)となりました。

半導体基板となるシリコンウェハーを高精度に平坦化・鏡面化する研磨工程で用いられる研磨材を製造販売する事業です。

■売上高(単位:百万円)



5.8%  
UP



シリコンウェハー

## CMP用

売上構成比

37.1%

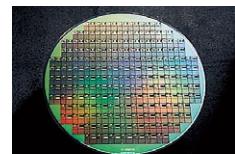
CMP向け製品につきましては、ロジックデバイス向け及びメモリデバイス向け製品の販売がともに増加したことにより、売上高は12,270百万円(前期比11.7%増)となりました。

半導体デバイスの製造工程で用いられる研磨材を製造販売する事業です。

■売上高(単位:百万円)



11.7%  
UP



デバイスウェハー

## ハードディスク用

売上構成比

11.0%

ハードディスク向け製品につきましては、為替の影響及び春先まで続いたハードディスクドライブメーカーの生産調整の影響により売上高は3,650百万円(前期比9.7%減)となりました。

パソコンやデータ保管をするサーバーの記憶装置に搭載されているハードディスク用基板の研磨材を提供しております。

■売上高(単位:百万円)



9.7%  
DOWN



サーバー

## 一般工業用・その他

売上構成比

23.4%

非半導体関連の一般工業用研磨材につきましては、最終製品の生産調整の影響により、売上高は5,150百万円(前期比4.7%減)となりました。その他につきましては、売上高2,582百万円(前期比7.3%増)となりました。

多種多様な用途向けに研磨材や材料を提供しております。また、鉄鋼、航空機及び半導体などさまざまな業界の溶射用途向けに溶射材を提供しております。

■売上高(単位:百万円)



1.0%  
DOWN



サファイア基板用の主力製品 COMPOL

## SCQI 賞の受賞

当社の米国子会社である FUJIMI CORPORATION が、米国インテル社より 2016 年度サプライヤー・コンテンツ・クオリティ・インフラメント (SCQI) 賞を受賞しました。

SCQI 賞はインテル社が最も傑出したサプライヤーを表彰するもので、品質、コスト、供給体制、技術力、カスタマー・サービス、労働及び倫理要件、環境面でのサステナビリティ (持続可能性) において、極めて高い水準を達成したサプライヤーに授与されます。



FUJIMI CORPORATION



撮影：Chip Holley and David Schmitz

## 子育てサポート企業認定マーク「くるみん」取得

当社は、厚生労働省の定める「次世代育成支援対策推進法」に基づいて策定した「行動計画」の計画内容を達成し、愛知労働局より「子育てサポート企業」として認定マーク (通称・くるみん) を取得しました。

なお、当社における「くるみん」の取得は今回が初めてとなります。

当社は、これからも「強く、やさしく、面白い会社」を目指し、「働きがい」と「働きやすさ」を実感できる組織づくり及び従業員の子育てサポート体制の充実に一層取り組んでまいります。

▼より詳しい情報はこちら

<http://www.fujimiinc.co.jp/csr/coexistence/activity.html>



※くるみんマークは平成 29 年 4 月 1 日からデザインが変更になっております。  
当社は平成 28 年 12 月 13 日の認定です。

## 連結財務諸表

連結損益計算書	前連結会計年度	当連結会計年度
	(自2015年4月1日 至2016年3月31日)	(自2016年4月1日 至2017年3月31日)
売上高	31,755	33,092
売上原価	19,353	19,568
売上総利益	12,402	13,524
販売費及び一般管理費	9,099	9,246
営業利益	3,302	4,278
営業外収益		
受取利息	28	25
その他	69	247
営業外収益合計	97	273
営業外費用	58	31
経常利益	3,342	4,519
特別損失	-	18
税金等調整前当期純利益	3,342	4,500
法人税、住民税及び事業税	733	1,282
法人税等調整額	262	△132
当期純利益	2,346	3,350
親会社株主に帰属する当期純利益	2,346	3,350

(単位：百万円)

### 売上高

世界半導体市場は、ロジックデバイス、メモリデバイスともに堅調な需要に支えられ、夏場以降、前年の実績を上回る形で推移し、成長基調となりました。その結果、シリコンウェハー向け及びCMP向け製品の販売が好調に推移したことから売上高は前期比4.2%増の33,092百万円となりました。

### 営業利益

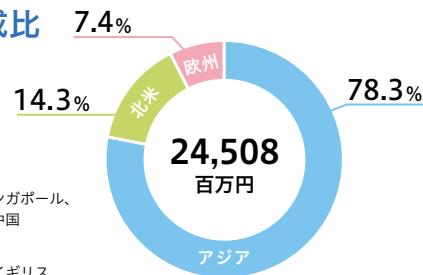
売上拡大とコスト削減に努めました結果、前期比29.5%増の4,278百万円となりました。

### 親会社株主に帰属する当期純利益

前期比42.8%増の3,350百万円となりました。

### 海外売上高構成比

(2017年3月期)



### 海外売上高

海外売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
	(自2015年4月1日 至2016年3月31日)	(自2016年4月1日 至2017年3月31日)
海外売上高	23,649	24,508
連結売上高	31,755	33,092
連結売上高に占める割合	74.5%	74.1%

(単位：百万円)

## 連結貸借対照表

前連結会計年度  
(2016年3月31日)

当連結会計年度  
(2017年3月31日)

資産の部		
流動資産		
現金及び預金	19,320	24,332
受取手形及び売掛金	6,669	7,239
有価証券	1,999	500
たな卸資産	5,383	5,721
繰延税金資産	448	544
その他	1,713	302
貸倒引当金	△11	△17
流動資産合計	35,525	38,623
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	7,341	7,262
その他（純額）	6,338	6,372
有形固定資産合計	13,680	13,635
無形固定資産	686	509
投資その他の資産		
投資有価証券	525	709
繰延税金資産	164	120
その他	112	109
貸倒引当金	△9	△9
投資その他の資産合計	793	930
固定資産合計	15,159	15,075
資産合計	50,684	53,699

(単位：百万円)

前連結会計年度  
(2016年3月31日)

当連結会計年度  
(2017年3月31日)

負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	2,703	3,226
未払法人税等	263	866
賞与引当金	785	1,002
その他	1,853	1,815
流動負債合計	5,605	6,911
固定負債		
繰延税金負債	8	7
退職給付に係る負債	526	579
その他	19	37
固定負債合計	554	623
負債合計	6,160	7,535
純資産の部		
株主資本		
資本金	4,753	4,753
資本剰余金	5,038	5,038
利益剰余金	40,042	41,013
自己株式	△5,725	△5,108
株主資本合計	44,109	45,697
その他の包括利益累計額	414	466
純資産合計	44,523	46,164
負債純資産合計	50,684	53,699

(単位：百万円)

## 営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動の結果得られた資金は、前年同期に比べて2,916百万円増加し、5,785百万円の収入となりました。これは、税金等調整前当期純利益の増加及び仕入債務の増加、法人税等の支払額の減少により資金の増加があったことによるものです。

## 投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動の結果使用した資金は、38百万円の支出となりました(前年同期は1,623百万円の収入)。これは、定期預金の払戻による収入が減少したことによるものです。

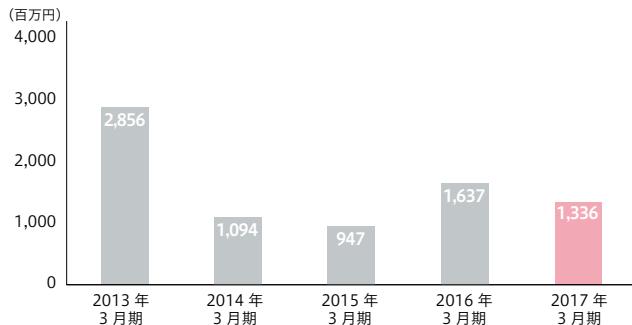
## 財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動の結果使用した資金は、前年同期に比べて、2,036百万円減少し、608百万円の支出となりました。これは、自己株式取得のための預託金の払戻による収入があったことによるものです。

## 配当金及び連結配当性向の推移

当社は、株主に対する適正な利益還元を行うことを経営の重要課題と認識し、配当につきましては平成31年3月期を目的に連結配当性向を50%以上とすることを目標として、業績に応じた積極的な株主還元を実施するとともに安定配当の継続にも留意することを基本方針としております。このような方針のもと、中間配当を含めた当期の配当金は、1株につき53円となります。次期につきましては、1株につき中間配当金25円、期末配当金28円とし、年間配当金は53円を予定してあります。

## ■設備投資



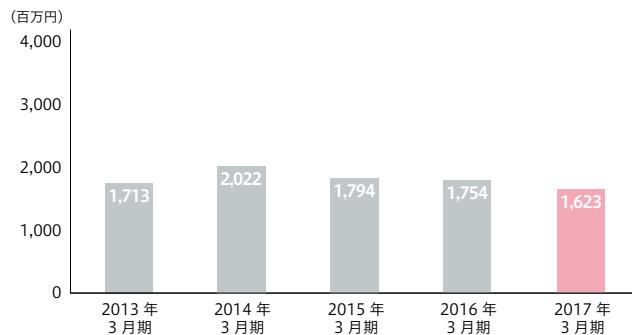
## 連結キャッシュ・フロー計算書

	前連結会計年度 (自2015年4月1日 至2016年3月31日)	当連結会計年度 (自2016年4月1日 至2017年3月31日)
●営業活動によるキャッシュ・フロー	2,869	5,785
●投資活動によるキャッシュ・フロー	1,623	△38
●財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,644	△608
現金及び現金同等物に係る換算差額	△453	△127
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	1,394	5,011
現金及び現金同等物の期首残高	18,426	19,820
現金及び現金同等物の期末残高	19,820	24,832

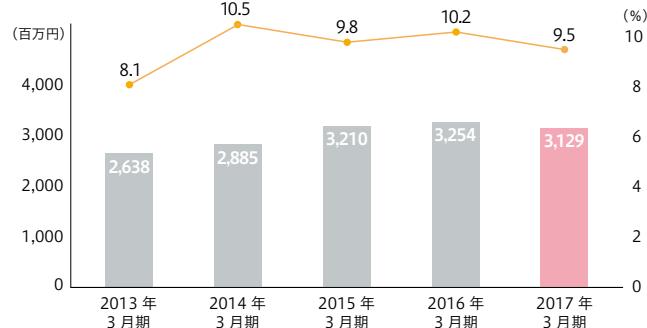
(単位：百万円)

■ 通期 ● 通期

## ■減価償却費



## ■研究開発費・売上高比



## 株式情報 2017年3月31日現在

### 株式の状況

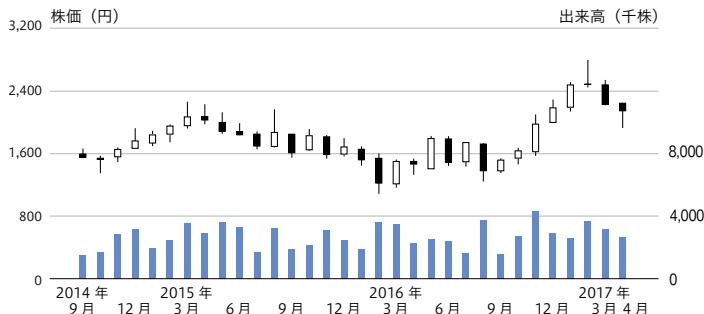
株式数	発行可能株式数	120,000千株
	発行済株式総数	28,699千株
	株主数	6,746名

### 大株主（株主名） 持株数（千株） 持株比率（%）

株式会社フジインコーポレーテッド	4,051	14.1
有限会社コマ	3,743	13.0
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	1,454	5.0
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）	1,337	4.6
BBH(LUX) FOR FIDELITY FUNDS PACIFIC FUND	938	3.2
株式会社三菱東京UFJ銀行	728	2.5
越山 勇	717	2.4
株式会社りそな銀行	691	2.4
日本生命保険相互会社	639	2.2
フジミ取引先持株会	621	2.1

※持株数は千株未満を切り捨て、持株比率は小数点第2位以下を切り捨ててしております。

## 株価及び出来高の推移

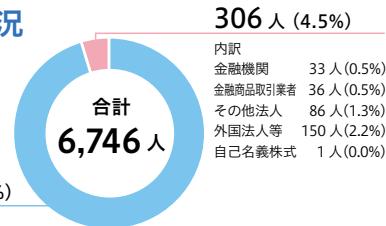


## 株主分布状況

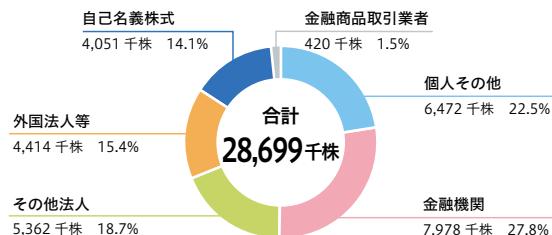
2017年3月31日現在

6,440人 (95.5%)

個人その他



所有者別株主数



所有者別持株数

## 役員

2017年  
6月23日現在

代表取締役社長	関 敬史
常務取締役	伊藤 広一
取締役	鈴木 彰
取締役	大脇 寿樹
取締役	鈴木 勝弘
取締役	川下 政美*
取締役	浅井 侯美*
常勤監査役	藤川 佳明
監査役	高橋 正彦**
監査役	岡野 勝**

(\*印は社外取締役) (\*\*印は社外監査役)

## 会社データ

2017年3月31日現在

商号	株式会社フジインコーポレーテッド
証券コード	5384
本社所在地	愛知県清須市西枇杷島町地領 2-1-1 TEL. 052-503-8181 (代表)
設立年月日	1953年(昭和28年)3月20日
資本金	4,753百万円
代表者	代表取締役社長 関 敬史
従業員	827名(個別568名)

# 株主メモ

2017年3月31日現在

決算日	3月31日
基準日	3月31日
単元株式数	100株
公告方法	電子公告 ( <a href="http://www.fujimiinc.co.jp">http://www.fujimiinc.co.jp</a> ) ただし、事故その他やむを得ない事情によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載することといたします。
株主名簿管理人	〒100-8212 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社
同事務取扱場所	〒100-8212 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
郵便物送付先 および照会先	〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-232-711 (通話無料)

## 各種手続のお申出先

- 支払期間経過後の配当金のお支払いについては、株主名簿管理人にお申出ください。
- 住所変更、単元未満株式の買取、配当金受取方法の指定等  
証券会社をご利用の株主様は、お取引の証券会社へお申出ください。  
証券会社をご利用でない株主様は、特別口座の口座管理機関である日本証券代行株式会社へお申出ください。

### 【ご注意】

特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、日本証券代行が口座管理機関となっておりますので、下記特別口座の口座管理人に、お問合わせください。

特別口座管理機関 連絡先	日本証券代行株式会社 〒168-8620 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 日本証券代行株式会社 代理人部 電話 0120-707-843 (通話無料)
-----------------	---

## 株式会社フジミインコーポレーテッド

お問い合わせ先：財務部経営企画課  
TEL：052-503-8181 (代表)  
URL：<http://www.fujimiinc.co.jp>

Copyright (C) 2017 Fujimi Incorporated. All rights reserved.



この印刷物は、環境負荷低減のため古紙パルプを80%使用した環境対応紙と、植物油を使用し、VOCの排出を抑えた環境対応型リサイクルインキ「ベジタブルインキ」を使用しております。